

Uniwersalna,  
wysokoelastyczna cementowa zaprawa klejąca

# PCI Nanolight®

do wszystkich rodzajów podłoża  
i wszystkich okładzin ceramicznych

# PCI®

Für Bau-Profis



## Zakres stosowania

- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
- Do ścian, posadzek i sufitów.
- Do wyklejania **metodą cienko- i średniowarstwową**, we wnętrzach i na zewnątrz budynków, chłonnych i niechłonnych okładzin ceramicznych: glazury, terakoty, kamionki, mozaiki ceramicznej, klinkieru, płytek ceglanych, cotto, gresu itp.
- Do stosowania na podłożach odkształcalnych i nieodkształcalnych, jak np.: beton monolityczny, tynki cementowe, wapienno-cementowe, wapienne i gipsowe, jastrychy i wylewki cementowe i anhydrytowe, lastriko, płyty kartonowo-gipsowe, cementowo-włóknowe, drewniane płyty wiórowe i płyty OSB, zespolone uszczelnienia podpłytkowe (np. PCI Lastogum®, PCI Seccoral®, PCI Barraseal®, PCI Apoflex®, PCI Pecilastic® W i U), stare powłoki malarskie, stare okładziny płytkowe, stare wykładziny PVC, ogrzewania podłogowe i ściennie, podłoża metalowe we wnętrzach obiektów, płyty budowlane PCI Pecidur®.
- Do klejenia płytek kamiennych niewrażliwych na przebarwienia oraz płytek i mozaiki szklanej.
- Do okładzin płytkowych w pomieszczeniach suchych i mokrych (łazienkach, umywalniach), na balkonach, tarasach, fasadach nieocieplonych i ocieplonych, w zbiornikach wodnych, w nieckach i na plażach basenów pływackich.
- Do okładzin posadzkowych narażonych na wysokie obciążenia mechaniczne i naprężenia wywołane zmianami temperatury.
- Do wyrównującego szpachlowania podłoża mineralnych w zakresie grubości 1 do 10 mm.
- Do przyklejania na podłożach betonowych, murowanych i tynkowanych płyt styropianowych w celu obwodowego ocieplenia podziemnych części budynków.
- Do przyklejania płyt styrodurów i z wełny mineralnej.
- W budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i przemysłowym.
- Idealna zaprawa klejąca do robót remontowych – uniwersalna, bardzo wydajna, o optymalnych parametrach czasowych.

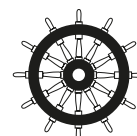


Wszechstronne stosowanie - do wszystkich podłoży i wszystkich okładzin ceramicznych

1211, 0767	
<b>PCI Augsburg GmbH</b> Piccardstraße 11 D-86159 Augsburg	
13 DE0017/02 PCI Nanolight® (DE0017/02) EN 12004:2007+A1:2012 Klej cementowy o podwyższonym czasie otwartym, odkształcalny, do płytek. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. EN 12004 C2TE S1	
Reakcja na ogień	Klasa A2-s1,d0 Klasa A2fl-s1
Przyczepność początkowa	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Przyczepność po starzeniu termicznym	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>
Przyczepność po cyklach zamrażania i rozmrażania	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>

Spełnia wymagania PN-EN 12004

**C2TE  
S1**



0801-11 / 0098-11

A brand of

**BASF**

We create chemistry

## Właściwości produktu

- **Odpowiada klasie C2TE S1 wg normy PN-EN 12004.**
- Doskonała urabialność i konsystencja.
- **Brak spływu** na powierzchniach pionowych, nie wymaga podparcia nawet płytek o znacznym ciężarze powierzchniowym.
- **Mrozo- i wodoodporna.**
- **Bezskurczowe** wiązanie w zakresie grubości warstw od **1 do 10 mm**.
- Wykazuje **wysoką (nawet do 2 N/mm<sup>2</sup>) przyczepność** po różnych rodzajach starzenia, nadaje się na najtrudniejsze podłoża (np. metalowe) oraz do najtrudniejszych okładzin (np. szklanych).
- **Wysoko-elastyczna (S1)** – kompensuje znaczne odkształcenia podłoża **wynikające np. z dużych zmian** temperatury.
- **Plastyczna** - łatwa w obróbce.
- Idealna w robotach remontowych: długi czas użycia i korekty, szybkie wiązanie.
- Ekologiczna – **niskopyląca i niskoemisyjna** w odniesieniu do substancji szkodliwych – oznaczony znakiem **EMICODE EC1 PLUS R**.

## Dane techniczne

Baza materiałowa	sucha mieszanka spoiw cementowych, kruszyw mineralnych i specjalnie dobranych dodatków	
Składniki	produkt 1-składnikowy	
Opakowanie	wzmocniony worek z uchwytem, 15 kg z wkładem polietylenowym nr art./EAN 3773/7	
Składowanie	w suchym miejscu, nie składować długotrwale w temperaturze powyżej +30°C	
Trwałość składowania	12 miesięcy	
Konsystencja	plastyczna	
Kolor	szary	
Paca zębata:	Zużycie/m <sup>2</sup> ok.:*	Wydajność worka 15 kg, ok.:*
- 4 mm	0,9 kg	16,6 m <sup>2</sup>
- 6 mm	1,3 kg	11,5 m <sup>2</sup>
- 8 mm	1,8 kg	8,3 m <sup>2</sup>
- 10 mm	2,1 kg	7,1 m <sup>2</sup>
Na m <sup>2</sup> i mm grubości warstwy	0,8 kg	
Grubość warstwy kleju	od 1 do 10 mm	
Temperatura aplikacji i podłoża	+5°C do +25°C	
Ilość wody zarobowej		
- na 1 kg suchej mieszanki	ok. 0,5 l	
- na worek 15 kg	ok. 7,6 l	
Czas dojrzewania	ok. 3 minuty	
Czas użycia**	ok. 90 minut	
Czas otwarty klejenia**	ok. 30 minut	
Czasy utwardzania**/**		
- wchodzenie możliwe po	ok. 8 godzinach	
- spoinowanie możliwe po	ok. 8 godzinach	
- pełne obciążenie możliwe po	ok. 24 godzinach	
Spływ	≤ 0,5 mm	
Przyczepność początkowa	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Przyczepność po zanurzeniu w wodzie	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Przyczepność po starzeniu termicznym	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Przyczepność po cyklach zamrażania – rozmrażania	≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>	
Odporność termiczna	-30°C do +80°C	
Reakcja na ogień	A2-s1,d0/A2fl-s1	

\* Na zużycie PCI Nanolight® wpływa wielkość i struktura tylnej strony zastosowanej okładziny oraz stopień wyrównania podłoża. W praktyce zużycie może wykazywać odchylenie od podanych wartości.

\*\* Przy +23°C i 50% względnej wilgotności powietrza. Wyższa temperatura i niższa wilgotność skracają, niższa temperatura i wyższa wilgotność wydłużają podane czasy.

\*\*\* Na podłożach o niskiej chłonności. W przypadku podłoży o normalnej chłonności czasy te mogą ulec skróceniu o niemal połowę.

## Przygotowanie podłoża

- Minimalny wiek podłoża:
  - jastrych PCI Novoment® M1 plus: ok. 24 godziny;
  - jastrych PCI Novoment® Z3: ok. 3 dni;
  - tradycyjna posadzka cementowa: ok. 28 dni;
  - tradycyjne tynki cementowe: ok. 28 dni;
  - beton: ok. 3 miesiące.
- Podłoże powinno być równe, zwarte, nośne i czyste, tj. pozbawione wszelkich substancji zmniejszających przyczepność.
- Do wyrównywania posadzek zaleca się użycie masy poziomującej PCI Pericem®. Do równania ścian i sufitów oraz do punktowego równania posadzek można użyć mas szpachlowych PCI Pericret®, PCI Nanocret® R2, PCI Nanocret® FC lub PCI Barrafill® 305.
- Silnie chłonne podłoża cementowe należy zagruntować środkiem PCI Gisogrund® w rozcieńczeniu 1:1 lub 1:2 z wodą albo PCI Gisogrund® OP w rozcieńczeniu 1:1 z wodą. Podłoża gipsowe zagruntować nie rozcieńczonym środkiem PCI Gisogrund® lub PCI Gisogrund® OP.

- Podłoża niechłonne (np. stare farby olejne, stare okładziny płytkowe, lastryko, płyty OSB, metal, PVC) należy zagruntować środkiem PCI Gisogrund® 404 lub PCI Gisogrund® 303.
- Podłoża drewniane i z materiałów drewnopochodnych gruntować środkiem PCI Wadian®.
- Maksymalna dopuszczalna wilgotność szczątkowa, mierzona metodą CM, powinna wynosić dla:
  - podłoży cementowych: 4%;
  - dla podłoży gipsowych: 0,5%.

## Sposób użycia

### Przygotowanie zaprawy klejowej

**1** Wlać do czystego naczynia odpowiednią ilość wody zarobowej. Wsypać zawartość opakowania i wymieszać odpowiednim mieszadłem (maks. 400 obr./min.) do uzyskania jednorodnej, pozbawionej grudek, plastycznej zaprawy.

**2** Odczekać ok. 3 minuty i powtórnie krótko wymieszać.

### Wyrównawcze szpachlowanie podłoża

**1** Aplikacja analogiczna jak w przypadku szpachlówek cementowych.

**2** W typowych warunkach po ok. 5 godzinach na ścianach i po ok. 24 godzinach na posadzkach na wyszpachlowanym podłożu można przyklejać płytki.

### Wyklejanie okładzin

**1** Najpierw gładką stroną pacy rozetrzeć na podłożu cienką warstwę kontaktową.

**2** Następnie odpowiednią pacą zębatą nanieść (możliwie w jednym kierunku) na świeżą warstwę kontaktową zaprawę klejową. Nanosić tylko tyle zaprawy, ile można obłożyć płytkami w czasie otwartym klejenia. Opuszkami

palca kontrolować czas naskórkowania zaprawy.

**3** Lekko posuwistym ruchem ułożyć płytki na zaprawie klejowej, docisnąć i ustawić we właściwym położeniu.

### Spoinowanie

- Do wypełnienia spoin użyć odpowiednich zapraw spoinowych, np. PCI Pericolor® Flex, PCI Nanofug®, PCI Nonofug® Premium czy PCI Durapox® NT plus.
- Spoiny dylatacyjne wypełnić właściwymi uszczelniaczami, np. PCI Silcofug® E lub PCI Elritan® 100.

## Zalecenia i uwagi

- W przypadku wyklejania kamieni naturalnych wrażliwych na odkształcenia i przebarwienia należy używać dedykowanych do tego zapraw klejowych PCI Carrament® lub PCI Carraflex®. W razie wątpliwości co do właściwości danego kamienia, zaleca się wykonanie próbnego przyklejenia i na tej podstawie dobranie odpowiedniej zaprawy klejowej.
- Do płytek i mozaiki wykonanych z przezroczystego szkła użyć białego kleju (PCI Carraflex® lub PCI Pericol® Flex White).
- Jeżeli spód okładziny szklanej pokryty jest materiałem wrażliwym na działanie alkaliów, użyć do jej przyklejenia epoksydowej zaprawy klejącej PCI Durapox® NT plus.
- Na balkonach, tarasach, elewacjach, ogrzewaniach podłogowych i ściennych, w basenach pływackich i kąpielowych oraz w przypadku okładzin płytkowych poddanych wysokim obciążeniom mechanicznym (np. naciskom kół pojazdów czy podpór ciężkich elementów wyposażenia), należy zastosować klejenie metodą kombinowaną lub użyć zaprawy płynnowarstwowej

PCI Pericol® Fluid, celem zapewnienia podklejenia min. 95% powierzchni płytki.

- Jastrychy z ogrzewaniem podłogowym należy przed wyklejeniem okładzin płytkowych poddać wstępnemu wygrzewaniu.
- Płyty wiórowe i płyty OSB winny mieć na ścianie grubość min. 19 mm, a na posadzce min. 25 mm. Należy je przykręcić do legarów nie rzadziej niż co 40 cm. Ten maksymalny rozstaw wkrętów obowiązuje w obu prostopadłych kierunkach. Obwodowa spoina dylatacyjna przy ścianach winna wynosić min. 8 mm. Styki płyt powinny być sklejone.
- Przy układaniu płytek w suchych wnętrzach na starych okładzinach

ceramicznych można zamiast gruntowania wykonać na tych okładzinach warstwę kontaktową z PCI Nanolight®. Przed przyklejeniem nowych płytek warstwa ta musi ulec utwardzeniu.

- Tężejącej zaprawy nie rozcieńczać wodą, ani nie mieszać ze świeżą zaprawą.
- Nie dodawać do zaprawy klejowej żadnych substancji poza czystą wodą zarobową.
- Jeśli nie ma innych wymagań, należy zapewnić podklejenie zaprawą klejową min. 65% powierzchni płytki.
- Przed spoinowaniem usunąć spoimiędzy płytek jeszcze w stanie świeżym resztki zaprawy klejowej.
- Płyty termoizolacyjne mogą być

generalnie przyklejane metodą „na placki”, chyba, że przewiduje się na nich dodatkowe warstwy materiałów. Wówczas konieczne jest przyklejanie pełnopowierzchniowe.

- Przed przyklejeniem płyt styrodurowych należy przetrzeć ich spodnią powierzchnię szczotką drucianą w celu poprawy przyczepności zaprawy klejącej.
- Nie stosować do przyklejania płyt styropianowych na podłożach bitumicznych.
- W przypadku klejenia płyt termoizolacyjnych na sufitach stosować dodatkowe dyblowanie ich do podłoża.
- Narzędzia zaleca się umyć wodą krótko po użyciu, gdyż później wymaga to więcej wysiłku.

## Wskazówki BHP

**Zawiera cement. Możliwe jest wystąpienie podrażnień skóry, ewentualnie poparzeń śluzówki (np. oczu). Działa drażniąco na drogi oddechowe. Ryzyko poważnego uszkodzenia oczu – należy unikać kontaktu z oczami oraz długotrwałego kontaktu ze skórą. Nie wdychać**

**pyłu. Zanieczyszczone oczy przeemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i przemyć zanieczyszczoną skórę dużą ilością wody z mydłem. Nosić odpowiednie rękawice**

**ochronne oraz okulary lub ochronę twarzy. W razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza – pokaż opakowanie lub niniejszą informację o produkcie. Chronić przed dziećmi.**

*Dalsze informacje znajdują się w karcie charakterystyki produktu.*

## Utylizacja odpadów

Dokładnie opróżnione opakowania po produktach PCI oraz pozostałe, nie wykorzystane resztki produktów należy usuwać zgodnie z obowiązującymi przepisami.

## Serwis dla projektantów

W sprawie doradztwa obiektowego i dodatkowych informacji należy zwracać się do regionalnych doradców techniczno-handlowych PCI.



### **Przedstawicielstwo i dystrybucja w Polsce:**

BASF Polska Sp. z o.o.  
Dział Chemii Budowlanej  
ul. Wiosenna 12  
PL 63-100 Śrem  
telefon 61 636 63 00  
faks 61 636 63 14  
[www.pci-polska.pl](http://www.pci-polska.pl)

W kartach technicznych podajemy ogólne wytyczne stosowania produktów. Rzeczywiste warunki aplikacji na budowach mogą odbiegać od informacji zawartych w niniejszej karcie technicznej. Z tego względu Użytkownik jest zobowiązany do dokonania sprawdzenia możliwości aplikacyjnych produktu w innych warunkach od podanych w karcie technicznej. W razie specjalnych wymagań należy zasięgnąć naszej porady technicznej.

Za niepełne i niewłaściwe dane w naszych kartach technicznych odpowiadamy tylko w razie rażącego zawinienia (działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa); powyższe nie dotyczy ewentualnych roszczeń z tytułu ogólnych przepisów o odpowiedzialności za produkt. Wydanie niniejsze traci aktualność z ukazaniem się nowego wydania karty technicznej.  
Wydanie kwiecień 2017.